

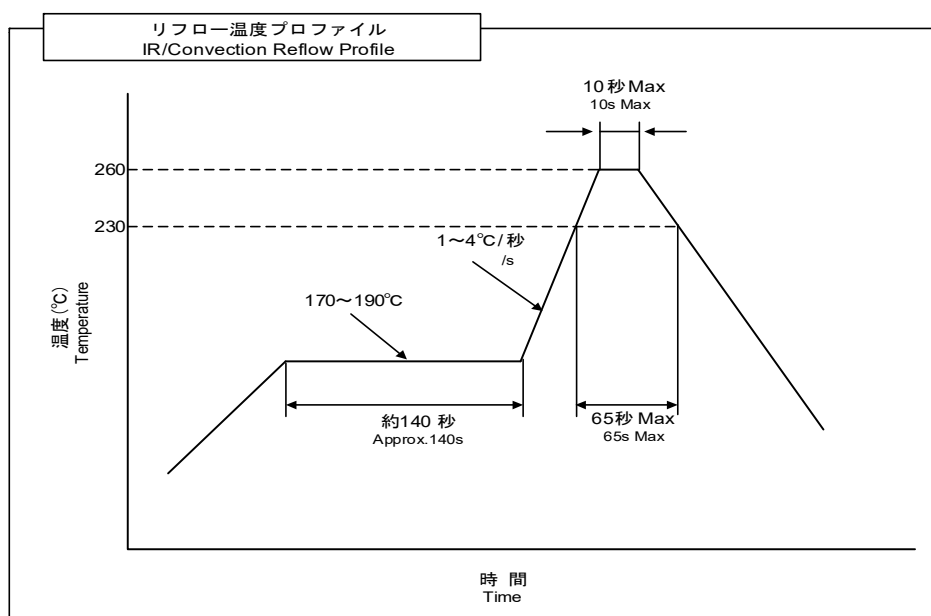
【パッケージ / Package : USP-10B03】

シリーズ名 Series Name	製品質量 (mg) Product Mass (mg)	MSL	リフロー Reflow ※	フロー Flow	手はんだ Manual ※
XCL208	16.5	3	可 available	不可 not available	可 available
XCL209					

※ はんだ付け条件 (以下の条件の範囲内でご使用下さい)

Soldering Conditions (please use within the following conditions.)

1) リフローはんだ(3回) / Reflow Soldering Temperature Profile (three times)



2) 手はんだ(2回) / Manual Soldering (twice)

こて先温度 350°C以下 時間 3秒以内 / Bit Temperature: Under 350°C Time: Under 3s